



裕太微电子  
Motorcomm

裕太微电子股份有限公司

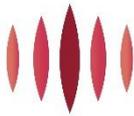
证券代码：688515

证券简称：裕太微

## 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：YT\_ZQSWB\_2024\_5\_4

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 公司现场接待 <input type="checkbox"/> 电话接待 <input checked="" type="checkbox"/> 其他场所接待 <input type="checkbox"/> 公开说明会 <input type="checkbox"/> 定期报告说明会 <input type="checkbox"/> 重要公告说明会 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与人员单位名称及姓名	兴证全球基金管理有限公司，张荣朗沐 睿远基金管理有限公司，钟明 华安基金管理有限公司，李欣、许瀚天、胡哲
日期时间	2024年5月17日
地点	上海市
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：王文倩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。</p> <p><b>一、介绍环节</b></p> <p>首先就公司2023年年度及2024年一季度经营情况做简要说明。</p> <p><b>二、互动交流环节</b></p> <p><b>1、目前行业景气度如何</b></p> <p>答：根据摩根大通证券近期《晶圆代工产业》报告，晶圆代工库存去化将结束，产业景气2024年下半年将广泛恢复，并于2025年进一步增强。非AI需求方面，3C领域的消费、通信、计算等垂直领域也在今年第1季触底；汽车、工业需求可能在2024年底、2025年初恢复，主因整体库存调整较晚，非AI需求逐渐恢复。2023年公司整体营收逐季呈环比增长的状态，2023年第四季度公司营业收入环比有较大幅度增长。预计2024年及</p>



	<p>之后,随着市场需求逐步复苏及客户库存逐步优化,下游客户需求有所增长,公司 2.5G 网通以太网物理层芯片、多口网通以太网交换机芯片、千兆网通以太网网卡芯片、车载芯片等持续放量以及其他高速有线通信新品的逐年推出,公司 2024 年及之后的营收预计会有所突破。</p> <p><b>2、公司目前的研发规划?</b></p> <p>答:公司目前已进入第三轮研发投入期,该轮次研发投入金额较大,研发投入周期较长,研发产品难度系数大幅提升。该轮次核心研发投入为补充 2.5G 系列网通产品、24 口及以下网通交换机芯片、车载高速视频传输芯片、车载以太网交换机芯片、车载网关芯片、5G/10G 网通以太网物理层芯片。目前公司车载以太网交换机芯片将于 24 年下半年送样,车载高速视频传输芯片将于近期送交客户演示。车载芯片产品后续将成为裕太微的重要增长极之一。上述一系列产品将陆续于 2024 年到 2026 年量产出货,为后续的营收份额的提升做出贡献。</p> <p><b>3、未来公司是否会加大 ESG 方面投入?</b></p> <p>答:公司高度重视 ESG 相关工作,公司的品牌精神为“万物互联、人心互通”,公司遵守法律法规、社会公德、商业道德,在坚持诚信经营、规范运作,保证企业持续发展的同时,积极履行社会责任,努力实现企业与社会、环境、股东、职工、客户、供应商等利益相关者的全面协调可持续发展,不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系,不断争取以更好的业绩回报广大投资者。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
附件清单(如有)	无